

MPL Series

High precision flipless cutting system.

高精度上下分断ラインシステム。

Scribing large-scale TFT substrates above and below simultaneously, this system is ideal for increasingly large substrates.

大型 TFT 基板を上下から同時にスクライブすることで、基板の大型化に対応。



The outside appearance and specifications are subject to change without notice.

外観、仕様は予告なしに変更になることがあります。

In-line Flipless Cutting System

上下分断ライン MPL シリーズ

MPL Series

MPL Specifications

Glass Thickness	対応基板厚み	Single Substrate / 単板	0.4mm-1.1mm
		Assembled Panel / 貼り合せ基板	0.8mm-2.2mm
Substrate Size	対応基板サイズ	G8 2,200×2,500mm MAX	
Scribe Velocity	スクライブ速度	600mm/sec MAX	
Scribe Accuracy	スクライブ精度	Straight Scribe / 直線	±40μm
Operating System	動作制御	PCWindows®OS	
Alignment System	画像認識	2cameras with auto alignment by gray image processing	
Dimensions(W×D×H)	装置寸法	Depend on customer specifications	お客様の仕様により異なります
Weight	重量	Depend on customer specifications	お客様の仕様により異なります

Applications

FPD, LCD, Optical Component, Solar Cells, Glass Cover (TV, Monitor) and other brittle materials.

CE marking accreditation is optionally available.

Contact

www.mitsuboshidiamond.com

※Trademarks and registered trademarks used herein are the property of their respective owners.
※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※The specs are subject to change without prior notice.
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。